



# 平成25年5月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)

平成25年3月27日

上場取引所 東

上場会社名 三益半導体工業株式会社  
コード番号 8155 URL <http://www.mimasu.co.jp>

代表者 (役職名) 取締役社長 (氏名) 中澤 正幸

問合せ先責任者 (役職名) 専務取締役管理本部長 (氏名) 八高 達郎

TEL 027-372-2011

四半期報告書提出予定日 平成25年4月12日

配当支払開始予定日 —

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無

四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

## 1. 平成25年5月期第3四半期の業績(平成24年6月1日～平成25年2月28日)

### (1) 経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
25年5月期第3四半期	34,843	10.1	1,424	△30.1	1,467	△22.8	872	△14.2
24年5月期第3四半期	31,659	△34.1	2,037	△42.6	1,899	△40.2	1,016	△45.2

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
25年5月期第3四半期	26.06	—
24年5月期第3四半期	30.36	—

### (2) 財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
25年5月期第3四半期	66,916	52,010	77.7
24年5月期	65,089	51,893	79.7

(参考) 自己資本 25年5月期第3四半期 52,010百万円 24年5月期 51,893百万円

## 2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
24年5月期	—	12.00	—	12.00	24.00
25年5月期	—	12.00	—	—	—
25年5月期(予想)	—	—	—	12.00	24.00

(注)直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

## 3. 平成25年5月期の業績予想(平成24年6月1日～平成25年5月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	44,000	4.6	1,950	△18.8	2,000	△9.3	1,200	1.0	35.84

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

※ 注記事項

(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(3) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)

25年5月期3Q	35,497,183 株	24年5月期	35,497,183 株
----------	--------------	--------	--------------

② 期末自己株式数

25年5月期3Q	2,015,361 株	24年5月期	2,015,059 株
----------	-------------	--------	-------------

③ 期中平均株式数(四半期累計)

25年5月期3Q	33,481,961 株	24年5月期3Q	33,482,370 株
----------	--------------	----------	--------------

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現時点で入手している情報及び合理的であると判断する前提に基づいたものであり、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信【添付資料】2ページ「(3) 業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報 .....	2
(1) 経営成績に関する定性的情報 .....	2
(2) 財政状態に関する定性的情報 .....	2
(3) 業績予想に関する定性的情報 .....	2
2. 四半期財務諸表 .....	3
(1) 四半期貸借対照表 .....	3
(2) 四半期損益計算書 .....	5
(3) 継続企業の前提に関する注記 .....	6
(4) セグメント情報 .....	6
(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 .....	6

## 1. 当四半期決算に関する定性的情報

## (1) 経営成績に関する定性的情報

当第3四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要等を背景として一部で持ち直しの動きが見られ、昨年末以降円高の是正も進みましたが、世界的な景気減速等の影響もあり全体として厳しい状況が続きました。

当社の主な需要先であります半導体業界におきましては、スマートフォン（高機能携帯電話）やタブレット端末の需要は堅調でありましたが、パソコンや薄型テレビなど民生用電子機器の需要が低調に推移したことから、引き続き厳しい事業環境となりました。

このような経営環境の中で当社は、自社開発製品の拡販を積極的に進めるとともに、徹底した合理化や効率化の推進、省電力対策の実施など、総力を挙げて業績の改善に取り組みました。

この結果、当第3四半期累計期間の売上高は348億4千3百万円と前年同四半期比10.1%の増収となり、営業利益は14億2千4百万円(前年同四半期比30.1%減)、経常利益は14億6千7百万円(同22.8%減)、四半期純利益は8億7千2百万円(同14.2%減)となりました。

半導体事業部

当事業部におきましては、全体的には厳しい状況が続いたものの、一部の生産は引き続き高水準で推移いたしました。そうした中で、更なる生産性の向上と徹底した原価低減を推進いたしました。

産商事業部

当事業部は自社開発製品及びその他の取扱商品の拡販活動に積極的に取り組みました。

エンジニアリング事業部

当事業部は開発部門としての役割に特化し、自社製品の開発を積極的に行い、産商事業部を通じて販売いたしました。

また、半導体事業部で使用する装置の開発や設計・製作にも意欲的に取り組みました。

## (2) 財政状態に関する定性的情報

当第3四半期会計期間末における総資産は、売上債権の増加等により、前事業年度末と比較して18億2千6百万円増加し、669億1千6百万円となりました。一方、負債合計は仕入債務の増加等により17億9百万円増加し、149億5百万円となりました。純資産合計は利益剰余金の増加6千8百万円等により、520億1千万円となりました。

## (3) 業績予想に関する定性的情報

平成25年5月期の業績予想につきましては、最近の業績動向等を踏まえ、業績予想を修正いたします。詳細につきましては、本日平成25年3月27日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。

2. 四半期財務諸表  
 (1) 四半期貸借対照表

(単位:百万円)

	前事業年度 (平成24年5月31日)	当第3四半期会計期間 (平成25年2月28日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	17,184	18,068
受取手形及び売掛金	14,490	15,912
商品及び製品	181	225
仕掛品	611	395
原材料及び貯蔵品	926	872
その他	2,103	357
貸倒引当金	△16	△18
流動資産合計	35,481	35,814
固定資産		
有形固定資産		
建物(純額)	14,069	13,136
その他(純額)	12,584	11,901
有形固定資産合計	26,653	25,038
無形固定資産		
投資その他の資産	1,283	1,050
その他	1,678	5,018
貸倒引当金	△6	△6
投資その他の資産合計	1,671	5,012
固定資産合計	29,608	31,101
資産合計	65,089	66,916
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	9,642	11,634
短期借入金	100	100
未払法人税等	—	260
引当金	58	424
その他	1,599	614
流動負債合計	11,400	13,034
固定負債		
長期借入金	250	375
退職給付引当金	1,358	1,312
その他	187	184
固定負債合計	1,796	1,871
負債合計	13,196	14,905

(単位:百万円)

	前事業年度 (平成24年5月31日)	当第3四半期会計期間 (平成25年2月28日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	18,824	18,824
資本剰余金	18,778	18,778
利益剰余金	17,699	17,767
自己株式	△3,409	△3,409
株主資本合計	51,891	51,960
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	1	50
評価・換算差額等合計	1	50
純資産合計	51,893	52,010
負債純資産合計	65,089	66,916

(2) 四半期損益計算書  
(第3四半期累計期間)

(単位:百万円)

	前第3四半期累計期間 (自平成23年6月1日 至平成24年2月29日)	当第3四半期累計期間 (自平成24年6月1日 至平成25年2月28日)
売上高	31,659	34,843
売上原価	27,819	31,702
売上総利益	3,840	3,140
販売費及び一般管理費	1,803	1,715
営業利益	2,037	1,424
営業外収益		
受取利息	4	7
受取配当金	4	4
為替差益	—	140
その他	17	31
営業外収益合計	27	183
営業外費用		
支払利息	2	1
設備休止費用	126	85
その他	35	53
営業外費用合計	164	140
経常利益	1,899	1,467
特別利益		
固定資産売却益	0	—
受取保険金	142	—
特別利益合計	143	—
特別損失		
固定資産売却損	0	0
固定資産除却損	36	11
災害による損失	10	—
特別損失合計	47	11
税引前四半期純利益	1,995	1,455
法人税、住民税及び事業税	163	320
法人税等調整額	815	263
法人税等合計	979	583
四半期純利益	1,016	872

## (3) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

## (4) セグメント情報

報告セグメントごとの売上高に関する情報

前第3四半期累計期間(自平成23年6月1日至平成24年2月29日)

(単位:百万円)

	報告セグメント				調整額	四半期 損益計算書 計上額
	半導体事業部	産商事業部	エンジニア リング事業部	計		
売上高						
外部顧客への売上高	18,986	12,673	—	31,659	—	31,659
セグメント間の内部売上高 又は振替高	3	—	1,353	1,356	△1,356	—
合計	18,989	12,673	1,353	33,016	△1,356	31,659

当第3四半期累計期間(自平成24年6月1日至平成25年2月28日)

(単位:百万円)

	報告セグメント				調整額	四半期 損益計算書 計上額
	半導体事業部	産商事業部	エンジニア リング事業部	計		
売上高						
外部顧客への売上高	15,993	18,850	—	34,843	—	34,843
セグメント間の内部売上高 又は振替高	4	—	959	964	△964	—
合計	15,997	18,850	959	35,807	△964	34,843

## (5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。